

# FFC用熱可塑型 電磁波シールドフィルム

## SF-FC700



SF-FC700は、ヒートシール型(熱可塑型)の電磁波シールドフィルムです。薄膜形成技術により、わずか30 $\mu$ mのフィルム厚を実現しました。超軽量で、屈曲性に優れているため、携帯機器や各種線材のシールドに最適です。

### 特徴

#### ▶超軽量・高屈曲

フィルムの厚さが29 $\mu$ mと薄く、超軽量・高屈曲

#### ▶低温・短時間接着

ヒートシール型導電性接着剤により、各種基材との接着が容易

#### ▶優れたシールド効果

表面抵抗200m $\Omega$ /□の金属薄膜層により、優れたシールド特性を実現

#### ▶自由度の高いフォルム幅

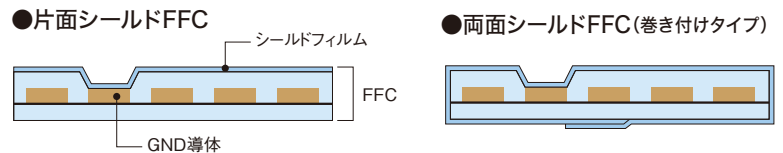
フィルム幅16mm~570mmの範囲から用途に合わせた選択が可能

#### ▶小ロット対応

必要に応じた量の生産が可能

### 製品仕様

項目	仕様	
離型フィルム	材質	OPP
	厚さ	40 $\mu$ m
導電性接着剤	樹脂	ポリエステル系(熱可塑型)
	フィラー	銀コート銅粉
	厚さ	20 $\mu$ m
	接着強度	4N/cm(対PET)
	接着条件	温度:120 $^{\circ}$ C 圧力:0.5~1.0MPa 時間:5~10sec
金属薄膜	材質	銀
	厚さ	800 $\text{Å}$ (約0.1 $\mu$ m)
	表面抵抗	200m $\Omega$ /□
ベースフィルム	材質	PET
	厚さ	9 $\mu$ m



### SF-FC700の構成

